

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年5月22日(22.05.2020)



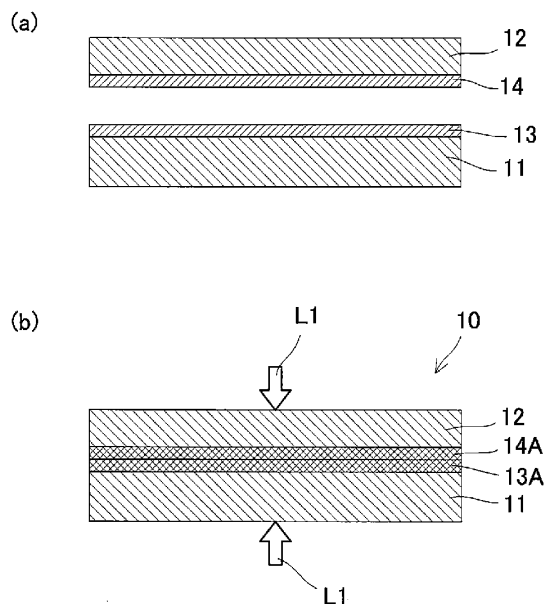
(10) 国際公開番号

WO 2020/100965 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) *C09J 5/06* (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01) *C09J 183/04* (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
C09J 5/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/044641
- (22) 国際出願日: 2019年11月14日(14.11.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2018-215862 2018年11月16日(16.11.2018) JP
- (71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 澤田 和宏 (SAWADA, Kazuhiro); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 森谷 俊介(MORIYA, Shunsuke); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 新城 徹也(SHINJO, Tetsuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP).
- (74) 代理人: 栗原 浩之, 外 (KURIHARA, Hiroyuki et al.); 〒1500012 東京都渋谷区広尾1丁

(54) Title: LAMINATE PEELING METHOD, LAMINATE, AND LAMINATE PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称: 積層体の剥離方法、積層体及び積層体の製造方法



(57) Abstract: The present invention comprises a first step and a second step. In the first step, when bonding a first substrate 11 made from a semiconductor-forming substrate and a second substrate 12 made from a support substrate that allows the passage of an infrared laser light, with a first adhesive layer 13 provided to the first substrate side and a second adhesive layer 14 provided to the second substrate 12 side, to constitute a laminate 10, the first adhesive layer 13 is made to serve as an adhesive layer by curing the adhesive (A) containing a component that is cured by a hydrosilylation reaction,

[続葉有]

目 3 番 1 5 号 岩 崎 ビ ル 6 階 栗 原 国
際特許事務所 Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

and the second adhesive layer 14 is made to serve as an adhesive layer which allows the passage of infrared light, obtained using an adhesive (B) which is a polymer adhesive having an aromatic ring on at least one of the main chain or a side chain. In the second step, the laminate is irradiated with infrared laser light from the second substrate side, peeling between the first adhesive layer and the second adhesive layer.

(57) 要約: 半導体形成基板からなる第1基体11と、赤外線レーザーを透過する支持基板からなる第2基体12とを、前記第1基体側に設けられた第1接着層13と、前記第2基体12側に設けられた第2接着層14とを介して接合して積層体10とする際に、前記第1接着層13を、ヒドロシリル化反応により硬化する成分を含有する接着剤(A)を硬化して得られる接着層とし、前記第2接着層14を、主鎖及び側鎖の少なくとも一方に芳香環を有する高分子系接着剤である接着剤(B)を用いて得られる、前記赤外線レーザーを透過する接着層とする、第1工程と、前記積層体の前記第2基体側から前記赤外線レーザーを照射し、前記第1接着層と前記第2接着層との間で剥離する第2工程とを含む方法。